

0.1. Factibilidad tecnológica

0.1.1. Esquema modular

0.1.2. Propuesta de alternativas de diseño

Para la medición de la temperatura se tuvieron en cuenta las diversas tecnologías que existen, poniendo en la balanza parametros que definen su performance tales como la linealidad de su salida, el costo, el rango de operación, la precisión, tipo de salida y aplicación. También se valoraron las diversas tecnologías que existen tales como la RTC cuyo funcionamiento se basa en el cambio de la resistencia en función de la temperatura bajo la ecuación $R(T) = R_0 + \alpha \cdot \Delta T$ también se consideró la tecnología TC la cual se basa en el *efecto seebek* y finalmente el uso de un IC el cual es basado en propiedades de dispositivos semiconductores extrínsecos.

0.1.3. Elección de una solución

0.1.4. DFMEA

0.2. Factibilidad de tiempos

0.2.1. Planificación

(PERT y simulación de Montecarlo)

0.2.2. Programación

(Gantt)

0.3. Factibilidad económica

(Mercado, costos, ciclo de vida, VAN, TIR)

0.4. Factibilidad legal y responsabilidad civil

(regulaciones y licencias)